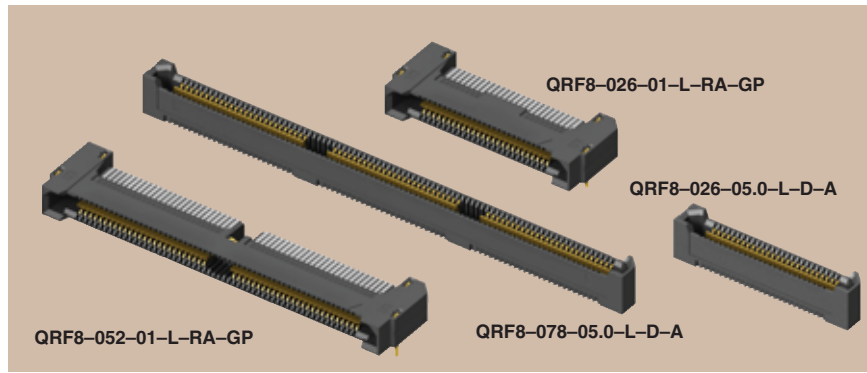




(0,80mm) .0315"

QRF8, QRF8-RA 系列



微塑体接地板

QRF8 板配接:

QRM8

QRF8-RA 板配接:

QRM8 (需要 -GP)

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?QRF8 或 www.samtec.com?QRF8-RA

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物

触点材料:
镀铜

接地板材料:
磷青铜

电镀:

50μ" (1,27μm) 的镍底上镀金或镀锡

额定电流:

QRF8 = 环境温度 80°C 时 2.0A

QRF8-RA = 95°C 时 1.5A

(6 个触点通电)

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

额定电压:

QRF8 = 215 VAC

QRF8-RA = 230 VAC / 325 VDC

符合 RoHS 规范要求:

是可无铅焊接:

是



QRF8 — 每排引脚数 对数 — 引线式样 — 电镀选项 — 类型 — **A** — 其他选项

-026, -052, -078
(每排共 52 个引脚 = -D)

-018, -036, -054
(每排 18 对 = -D-DP)

-05.0
= 5mm 主体高度

-07.0
= 7mm 主体高度

-L
= 触点镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀雾锡

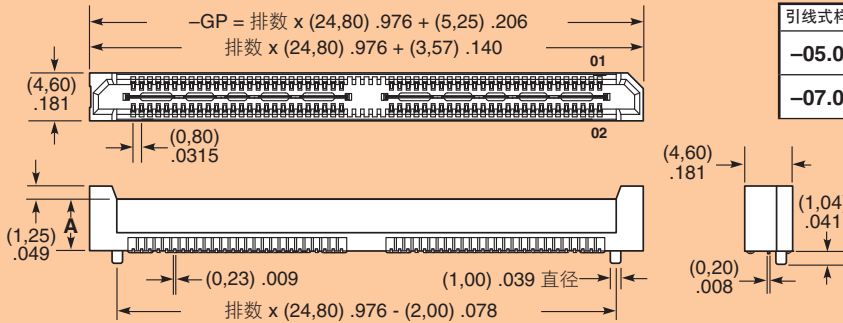
-D
= 单端

-D-DP
= 差分对

-GP
= 导柱 (配连接
连接器需要 -GP)

-K
= (5,00mm)
.197" 直径聚酰
亚胺薄膜取放垫

-TR
= 卷带封装



引线式样	A
-05.0	(5,01) .197
-07.0	(7,01) .276



配接高度*		
QRF8 引线式样	QRM8 引线式样	
	-02.0	-05.0
-05.0	(7,00) .276	(10,00) .394
-07.0	(9,00) .354	(12,00) .472

*加工条件将影响配接高度。

7mm 堆叠高度	类型	在 3dB 插入损耗的额定值
单端信号传输	-D	9.5 GHz / 19 Gbps
差分对信号传输	-DP	8.5 GHz / 17 Gbps

如需了解其他堆叠厚度的性能数据和完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com?QRF8 或联系 sig@samtec.com

注: 提供其他镀金选项。请联系 Samtec。

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

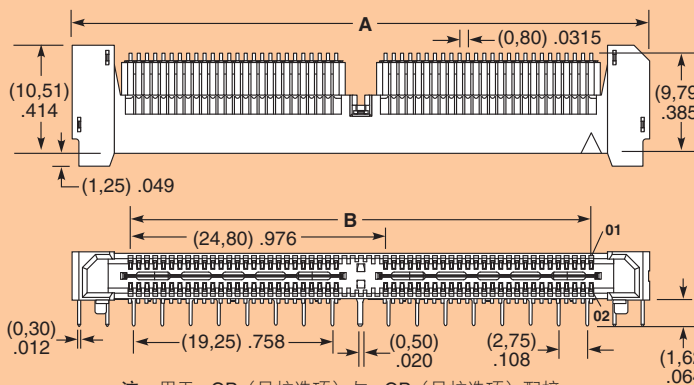
QRF8 — 每排位置数 — **01** — 电镀选项 — **RA** — **GP** — 选项

-026, -052, -078
(每排共 52 个位置)

-L
= 触点镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀雾锡

-K
= (7,00mm) .275" 直径
聚酰亚胺薄膜取放垫
(仅 -052)

-TR
= 卷带封装



每排位置数	A	B
-026	(31,35) 1.234	(20,00) .787
-052	(56,15) 2.211	(44,80) 1.764
-078	(80,95) 3.187	(69,60) 2.74

注: 用于 -GP (导柱选项) 与 -GP (导柱选项) 配接。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。